

(19) 대한민국특허청(KR)  
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> H01H 85/08	(11) 공개번호 특 1995-0001817
	(43) 공개일자 1995년 01월 04일
(21) 출원번호	특 1994-0011462
(22) 출원일자	1994년 05월 26일
(30) 우선권주장	93-167245 1993년 06월 01일 일본(JP)
(71) 출원인	에스. 오. 씨 가부시끼가이샤 아리까와 히로오 일본국 도쿄도 미나토구 미따 3쵸메 11반 36고
(72) 발명자	아리까와 히로오
(74) 대리인	일본국 도쿄도 세따가야구 오야마다이 1쵸메 14-9 송재연, 한규환

**심사청구 : 있음**

**(54) 칩 퓨즈**

**요약**

본 발명은 칩 퓨즈에 관한 것으로서, 특히 퓨즈 본체와 유도단자들이 단단히 고정된 구조의 칩 퓨즈에 관한 것이다. 본 발명은 중공 절열본체와, 구멍을 따라 연장된 가용성 부재와, 본체의 단부와 맞물린 각각 단부와, 그 본체의 단부상에 맞춰진 두개의 단자들과, 각 단자에 포함되어 본체의 단부면에 단자를 고정시키는 돌출부를 포함하는 칩 퓨즈를 개시하고 있다. 그 본체는 각 돌출부가 맞추어지는 두개의 그루브를 포함할 수도 있다.

**대표도**

**도 1**

**명세서**

[발명의 명칭]

칩 퓨즈

[도면의 간단한 설명]

제 1 도는 본 발명에 따른 조립전의 칩 퓨즈 구성요소들의 구조를 나타내고, 제 2 도는 제 1도에서 나타낸 구성요소들을 이용하여 조립된 칩 퓨즈 필수부분의 확대단면도이며, 제 3 도는 본 발명에 따른 조립전의 다른 칩 퓨즈 구성요소들의 구조를 나타내고, 제 4 도는 제 3 도에서 나타낸 구성요소들을 이용하여 조립된 칩 퓨즈 필수부분의 확대단면도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

**(57) 청구의 범위**

**청구항 1**

칩 퓨즈에 있어서, 상호 대향 이격된 한쌍의 다각형 단부면들과, 상기 한쌍의 다각형 단부면들에 부착되어 이들 사이에 연장된 측면들과, 상기 본체내에 형성되어 상기 한쌍의 단부면들 사이에서 상기 본체를 통해 연장된 관통공과, 한개의 상기 단부면들에 거의 평행한 방향으로 상기 단부면들중 하나의 단부면 부근의 상기 측면들중 하나의 측면들중에 제공되며 다른 한개는 상기 단부면들에 거의 평행한 방향으로 상기 단부면들중 다른 하나의 단부면 부근에서 상기 측면들중 하나의 측면상에 마련되는 두개의 그루브를 구비하는 내열성 절연재로 만들어진 본체와 ; 길이가 상기 관통공의 길이보다 더 길고, 상기 본체내의 상기 관통공내에 배치되어 상기 관통공을 통해 연장되고, 각각의 단부면들은 상기 본체의 상기 측면들중 하나의 측면과 상기 각 단부면들을 따라 연장되며 접촉되도록 상기 본체의 상기 한쌍의 단부면들중 단부면상에 각각 맞추어지고, 상기 본체의 각 다각형 단부면에 대향하는 내부면을 가진 다각형 벽과, 상기 다각형벽의 돌레로부터 각도를 이루어 연장되어 상기 본체의 상기 한쌍의 단부면들 각각의 부근에서 상기 측면들을 커버하는 측벽들과, 상기 측벽들중 하나의 측벽상에 제공되어 상기 본체의 상기 그루브들중 대응 그루브내로 맞추어지는 적어도 한개의 돌출부재를 각각 구비한 한쌍의 전도단자들을 포함하는 한쌍의 전도단자부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

**청구항 2**

제 1 항에 있어서, 상기 돌출부재는 상기 돌출부재가 설치된 측벽들중 상기 하나의 측벽에 적어도 두개의 절단부를 제공하고 상기 적어도 두개의 절단부 사이에 위치한 부분을 내측으로 구부림으로써 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

**청구항 3**

제 1 항에 있어서, 상기 돌출부재는 프레스에 의해 상기 돌출부재가 제공된 상기 측벽들중 상기 하나의 측벽부분을 내측으로 돌출시킴으로써 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

**청구항 4**

제 1 항에 있어서, 상기 돌출부재는 상기 전도단자부재의 상기 측벽들중 하나를 연장하고 상기 측벽들중 상기 하나의 측벽의 연장부분을 내측으로 구부림으로써 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

**청구항 5**

제 4 항에 있어서, 상기 돌출부재는 상기 연장부분을 U자형 구조로 구부림으로써 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

**청구항 6**

제 1 항에 있어서, 상기 돌출부재는 상기 전도부재의 상기 측벽들중 하나의 측벽의 단부를 내측으로 구부림으로써 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

**청구항 7**

칩 퓨즈에 있어서, 상호 대향 이격된 한쌍의 다각형 단부면들과, 상기 한쌍의 다각형 단부면들에 부착되어 이들 사이에 연장된 측면들과, 상기 본체내에 형성되어 상기 한쌍의 단부면들 사이에서 상기 본체를 통해 연장된 관통공을 가지고 있는 내열성 절연재로 만들어진 본체와; 상기 관통공의 길이보다 길고, 상기 본체내의 상기 관통공내에 배치되어 상기 관통공을 연장되어 있으며, 상기 본체의 상기 측면들중 하나의 측면과 각각의 상기 단부면을 따라 연장되고 접촉된 단부를 구비함으로써 상기 본체에 맞물리는 가늘고 긴 가용성 부재와; 상기 가용성 부재의 각각의 단부에 전기접속되도록 상기 본체의 상기 한쌍의 단부면들중 대응 단부면상에 각각 맞춰지고, 상기 본체의 개별 다각형 단부면을 대향한 내부면을 가진 다각형 벽과, 상기 다각형 벽의 둘레로부터 각지게 연장되고 상기 본체의 상기 한쌍의 단부면들중 하나의 단부면 각각의 부근에서 상기 측면들을 커버하는 측벽들과, 상기 측벽들중 하나의 측벽상에 제공되고 상기 본체에 상기 전도단자를 고정시키도록 상기 본체의 상기 측벽들중 대응 측벽과 마찰에 의해 접촉되는 적어도 하나의 돌출부재를 각각 구비한 한쌍의 전도단자부재를 포함하는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

**청구항 8**

제 7 항에 있어서, 상기 돌출부재는 상기 돌출부재가 제공된 상기 측벽들중 상기 하나의 측벽에 적어도 두개의 절단부를 제공하고 상기 적어도 두개의 절단부 사이에 위치한 부분을 내측으로 구부림으로써 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

**청구항 9**

제 7 항에 있어서, 상기 돌출부재는 프레스에 의해 상기 돌출부재가 제공된 상기 측벽들중 상기 하나의 측벽 부분을 내측으로 돌출시킴으로써 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

**청구항 10**

제 7 항에 있어서, 상기 돌출부재는 상기 전도단자부재의 상기 측벽들중 하나의 측벽을 연장시키고 상기 측벽들중 상기 하나의 측벽의 연장부분을 내측으로 구부림으로써 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

**청구항 11**

제 7 항에 있어서, 상기 돌출부재는 상기 연장부분을 U자형 구조로 구부림으로써 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

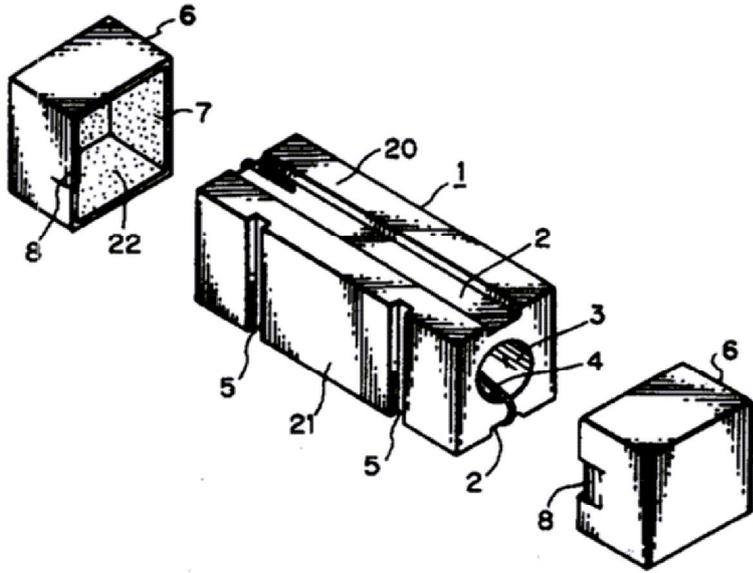
**청구항 12**

제 7 항에 있어서, 상기 돌출부재는 상기 전도단자부재의 상기 측벽들중 하나의 측벽의 단부를 내측으로 구부림으로써 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 칩 퓨즈.

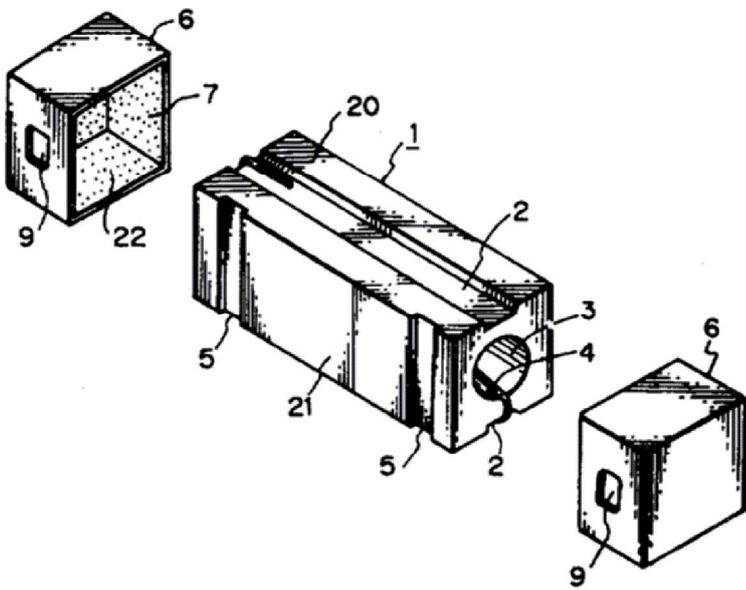
※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

**도면**

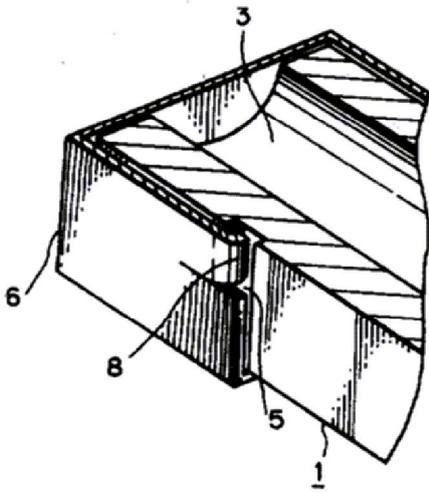
도면1



도면3



도면2



도면4

